

32 位微控制器

HC32L110 系列的 RTC 硬件补偿算法

适用对象

但用对象		
系列	产品型号	
HC32L110	HC32L110C6UA	
	HC32L110C6PA	
	HC32L110C4UA	
	HC32L110C4PA	
	HC32L110B6PA	
	HC32L110B4PA	



目 录

1	摘要	. 3		
	功能介绍			
3	硬件补偿原理介绍	. 4		
	3.1 硬件平台	. 4		
4	补偿算法介绍			
5	拟合晶振曲线补偿介绍			
	5.1 高低温拟合晶振温漂曲线	. 7		
	5.2 自动补偿原理	. 7		
6	参考样例及驱动			
7	总结	. 8		
8	其他信息			
9	版本信息 & 联系方式			



1 摘要

本篇应用笔记主要介绍 HC32L110 系列的 RTC 硬件补偿算法。

本篇应用笔记主要包括:

- 硬件补偿原理介绍
- 补偿算法介绍
- 拟合晶振曲线补偿介绍

注意:

一本应用笔记为 HC32L110 系列的应用补充材料,不能代替用户手册,具体功能及寄存器的操作等相关事项请以用户手册为准。

2 功能介绍

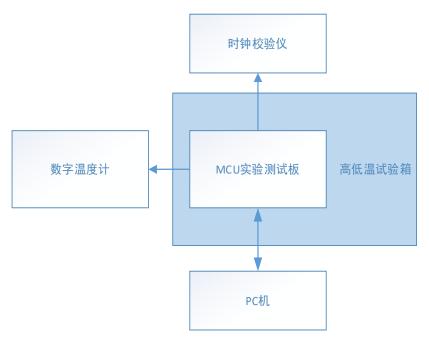
HC32L110 系列 RTC 模块硬件补偿算法,基于高速 24M 时钟补偿时,能够实现最小补偿单位 0.96ppm 的精度,能够满足高精度的时钟补偿要求。

应用笔记 Page 3 of 9



3 硬件补偿原理介绍

3.1 硬件平台

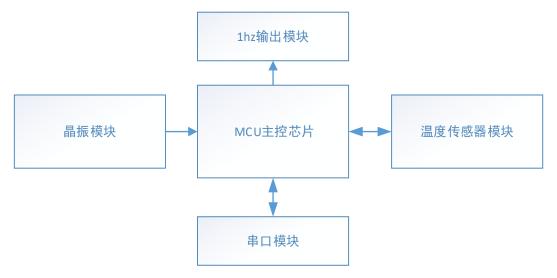


- 实验测试板放入高低温试验箱,且测试板正常供电
- 时钟校验仪连接到测试板的 1hz 输出口检测时钟误差
- 数字温度计热电偶线放入测试板位置,直接读取测试点温度值
- PC 机串口与测试板 UART 正确连接,方便用户交互数据

应用笔记 Page 4 of 9



MCU 实验测试板硬件框图:



- 晶振模块为 RTC 时钟模块提供计数时钟源
- 1hz 输出模块为时钟校验仪提供测试源
- 温度传感器模块实时测量当前温度值
- 串口模块为用户提供数据交互载体

实验前要根据 1hz 输出精度来调整外部 32k 晶振匹配电容大小,以保证高低温下误差在校准范围内。

应用笔记 Page 5 of 9



4 补偿算法介绍

基于自身 32.768khz 的 RTC,每秒补偿单位是 1/32768=30.5ppm,不能满足高精度要求。算法上扩大 32 倍后,能够实现 30.5/32=0.96ppm,所以补偿寄存器引入了 5 位小数的设定。为了提升补偿精度,需要将补偿时钟源提高。

如果补偿时钟源选择 24M 的话,那么 23 个 24M 时钟 clk 代表 1hz 时钟周期,这样补偿就可以实现每 HZ 精准校准的功能。

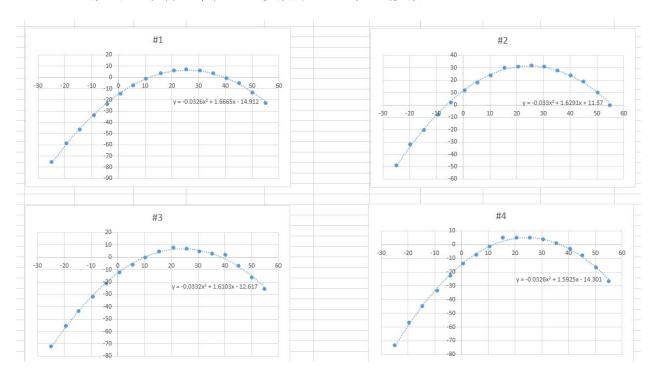
应用笔记 Page 6 of 9



5 拟合晶振曲线补偿介绍

5.1 高低温拟合晶振温漂曲线

高低温实验下,将不同温度下对应的 1hz 误差 ppm 记录,根据实验数据点来进行抛物线拟合。拟合后可以得出每个 MCU 参数的 1hz 温漂曲线参数。



5.2 自动补偿原理

拟合抛物线参数后,将抛物线参数写入程序中,根据抛物线参数及实时温度,计算此时 ppm 值,然后根据补偿公式计算出补偿值,写入补偿寄存器实现 1hz 程序自动补偿功能。

补偿寄存器
$$CR[8: 0] = (\frac{补偿目标值[PPM]*2^{15}}{10^6})_{\text{取2 的补码}} + 0001.00000B$$

应用笔记 Page 7 of 9



6 参考样例及驱动

通过上述介绍,配合 HC32L110 系列的用户手册,我们对上述系列 MCU 的 RTC 硬件补偿算法应用及操作方法有了进一步的掌握。

小华半导体(XHSC)官方同时提供了该模块的应用样例及驱动库,用户可通过打开样例的 工程进一步直观地熟悉该模块以及驱动库的应用,在实际开发中也可以直接参考样例和使用 驱动库来快速实现对该模块的操作。

- ▶ 样例参考: ~/HC32L110 DDL/example/rtc
- ➤ 驱动库参考: ~/HC32L110_DDL/driver/.../rtc

7 总结

以上章节简要介绍了 HC32L110 系列的 RTC 硬件补偿算法,详细说明了该补偿功能的操作步骤。用户在实际的应用开发过程中,如果需要更深一步了解该模块的使用方法及操作事项,应以相应的用户手册为准。本章中提到的样例及驱动库,既可以作为用户进一步的实验与学习,也可以在实际开发中直接应用。

8 其他信息

技术支持信息: http://www.xhsc.com.cn

应用笔记 Page 8 of 9



9 版本信息 & 联系方式

日期	版本	修改记录
2018/5/31	Rev1.0	初版发布。
2022/7/15	Rev1.1	公司 Logo 更新。



如果您在购买与使用过程中有任何意见或建议,请随时与我们联系。

Email: mcu@xhsc.com.cn

网址: http://www.xhsc.com.cn

通信地址:上海市浦东新区中科路 1867号 A座 10层

邮编: 201203



应用笔记 AN0051014C